Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST




# Lotpaste SP2200D TSC305 Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 10cc Kartusche

Artikel-Nr: 692208
Lagerbestand: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 26.30

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20+ | ~~CHF 26.30~~ | CHF 23.10 | (12% sparen) |

## Beschreibung

Die STANNOL SP2200D Lotpaste ist für den Einsatz mit der Legierung TSC305 (Sn96,5Ag3,0Cu0,5) und anderen entwickelt worden. Sie enthält ein hochaktives Typ L No-Clean Flussmittel. Mit einer speziellen Formel für ausgezeichnete Benetzung erfüllt sie die Anforderungen einer Grossserienfertigung, bei der die Bauteile und Leiterplatten oftmals eine nicht optimale Lötbarkeit aufweisen. Die Benetzungseigenschaften wurden für alle bekannten bleifreien Leiterplatten- und Bauteilbeschichtungen optimiert. Die geringen Mengen an Rückständen nach dem Reflow sind elektrisch sicher und müssen nicht entfernt werden.

## Technische Daten

- Speziell zum Einsatz mit bleifreien Legierungen entwickelt
- Reflow unter Luft oder Stickstoff möglich
- Sehr gute Benetzung auf den meisten Oberflächen, auch Ni und Pd
- Verarbeitungstemperatur 20-32°C
- Hohe Nassklebekraft für Einsatz auf High-Speed Bestückautomaten
- Gute Dispens-Eigenschaften

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | STANNOL |
| **Bleihaltig** | Nein |
| **Flussmittel** | REL0 |
| **Gebinde** | Kartusche |
| **Gebindegrösse (g)** | 40 |
| **Korngrösse** | 3 |
| **Legierung** | Zinn/Silber/Kupfer |
| **Haltbarkeit** | 12 Wochen |

| | |
|---|---|
| **Schmelztemperatur (°C)** | 217-223 |